

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下駿碼半導體材料有限公司（「本公司」）所有股份，應立即將本通函交予買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購本公司證券的要約。

---



### 有關收購知識產權的重大關連交易 及 更改股份發售所得款項用途

本公司的財務顧問



八方金融有限公司

獨立董事委員會及獨立股東的  
獨立財務顧問



衍丰企業融資有限公司

---

本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

本公司謹訂於2023年8月2日（星期三）下午二時三十分假座香港新界白石角香港科學園二期尚湖樓2樓208室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），召開大會之通告載於本通函第EGM-1至第EGM-2頁。本通函隨附股東於股東特別大會上使用之代表委任表格。本代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nichetech.com.hk)。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請細閱本通函，將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快且無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

2023年7月18日

---

## GEM 的特色

---

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
GEM的特色.....	i
釋義.....	1
董事會函件.....	5
獨立董事委員會函件.....	14
獨立財務顧問函件.....	16
附錄一 – 本集團的財務資料.....	I-1
附錄二 – 估值報告.....	II-1
附錄三 – 一般資料.....	III-1
股東特別大會通告.....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據該協議收購知識產權
「該協議」	指	駿碼科技(香港)與BVI Holdings就收購事項而於2023年6月14日訂立的協議
「銀行融資」	指	由一間香港持牌銀行將予授出最高15.0百萬港元的銀行融資，用於收購知識產權
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日及香港公眾假期以外的任何日子
「BVI Chows」	指	Chows Investment Group Limited，一間於2016年9月28日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，分別由周博士及周教授直接及實益擁有40%及60%
「BVI Holdings」或「賣家」	指	駿碼科技投資控股有限公司，一間於2016年10月14日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由BVI Chows直接、實益及全資擁有
「COB封裝技術」	指	製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術
「本公司」	指	駿碼半導體材料有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8490)
「完成」	指	根據該協議完成收購事項
「關連人士」	指	具GEM上市規則賦予之涵義
「代價」	指	收購事項的總代價38.0百萬港元

---

## 釋 義

---

「控股股東」	指	具GEM上市規則所賦予的涵義，包括有權於本公司股東大會行使30%或以上投票權或可控制董事會大部分成員組成的任何人士或一組人士
「董事」	指	本公司董事
「周博士」	指	周博軒博士，本公司執行董事、執行主席兼控股股東
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，以考慮並酌情批准有關該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)的普通決議案
「FC-BGA封裝技術」	指	製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「衍丰企業融資」或「獨立財務顧問」	指	衍丰企業融資有限公司，為根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，即就(其中包括)該協議項下擬進行的交易(包括收購事項)的條款是否屬公平合理，以及有關條款是否符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及股東提供意見的獨立財務顧問
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事(即吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生)組成的董事會獨立委員會，以就該協議項下擬進行的交易(包括收購事項)向股東提供意見

---

## 釋 義

---

「獨立股東」	指	無須於批准該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)的股東特別大會上放棄投票的股東
「獨立估值師」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，由本公司就知識產權進行估值而委聘的獨立估值師
「知識產權」	指	COB封裝技術及FC-BGA封裝技術的知識產權
「最後實際可行日期」	指	2023年7月13日
「截止日期」	指	該協議的截止日期，將為2023年11月30日下午四時正或之前(或訂約方可能同意的較後日期，即香港銀行開放營業的日子，惟星期六、星期日或公眾假期除外)
「Mini-LED」	指	迷你發光二極管
「所得款項淨額」	指	股份發售所得款項淨額
「駿碼科技(香港)」 或「買家」	指	駿碼科技(香港)有限公司，一間於2012年4月26日於香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「初步估值」	指	估值報告初稿
「先前公佈」	指	本公司日期為2021年7月30日的公佈，內容有關收購知識產權及更改所得款項淨額用途
「周教授」	指	周振基教授，本公司執行董事及控股股東
「招股章程」	指	本公司日期為2018年5月17日的招股章程

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份發售」	指	招股章程所述的公開發售及股份配售
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「估值」	指	由獨立估值師編製的知識產權於2023年4月30日的最終估值



**Niche-Tech Semiconductor Materials Limited**

**駿碼半導體材料有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

執行董事：

周博軒博士  
周振基教授  
石逸武先生

非執行董事：

李超凡先生

獨立非執行董事：

吳宏偉教授  
潘禮賢先生  
戴進傑先生

敬啟者：

開曼群島註冊辦事處：

Windward 3  
Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港新界  
白石角香港科學園  
二期尚湖樓2樓208室

## 有關收購知識產權的重大關連交易 及 更改股份發售所得款項用途

### 緒言

於2023年6月14日，駿碼科技(香港)與BVI Holdings訂立該協議，據此，駿碼科技(香港)同意購買而BVI Holdings(作為實益擁有人)同意出售知識產權。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)該協議詳情；(ii)獨立董事委員會就該協議及其項下擬進行的交易提出的建議；(iii)獨立財務顧問就該協議及其項下擬進行的交易提供的意見；(iv)股東特別大會通告；及(v)GEM上市規則規定的其他資料。

該協議的主要條款概要如下：

### 日期

2023年6月14日

### 訂約方

- (i) 駿碼科技(香港)，作為買家；及
- (ii) BVI Holdings，作為賣家。

### 買賣知識產權

根據該協議的條款及條件，BVI Holdings作為實益擁有人出售知識產權予駿碼科技(香港)，駿碼科技(香港)將向BVI Holdings購買知識產權，且不附帶任何產權負擔。

### 知識產權

知識產權包括COB封裝技術及FC-BGA封裝技術。

COB封裝技術為製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術。董事會認為，COB封裝技術可採用用於Mini-LED行業的環氧樹脂瞬間固化技術。COB封裝技術由BVI Holdings開發，具有高韌性、低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。COB封裝技術適用於小間距RGB Mini-LED模組。

FC-BGA封裝技術為製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術。董事會認為，FC-BGA封裝技術通過改變樹脂、促進劑及多元醇的類型及結構，可改進用於封裝的環氧樹脂成型材料及提高成型工藝的持續性，並具有低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點，適用於Mini-LED模組封裝的注塑工藝。

## 代價及付款

根據該協議，收購COB封裝技術及FC-BGA封裝技術分別為28.2百萬港元及9.8百萬港元。因此，代價應為38.0百萬港元。

COB封裝技術及FC-BGA封裝技術的估值乃由獨立估值師於2023年4月30日按照國際評估準則理事會頒佈的國際評估準則根據成本法估值，分別約為29.5百萬港元及10.2百萬港元。估值所用的關鍵假設及所採納方法的詳情及基準載於本通函附錄二的估值報告。代價較估值折讓約4.3%。

代價應由駿碼科技(香港)以下列方式支付：

- (i) 12.0百萬港元代價已於該協議簽署日期支付予BVI Holdings作為按金；
- (ii) 12.0百萬港元代價須於股東特別大會上獲得獨立股東批准及就銀行融資獲得一間香港持牌銀行批准後以現金支付予BVI Holdings；
- (iii) 12.0百萬港元代價須於完成後以現金支付予BVI Holdings；及
- (iv) 餘下2.0百萬港元代價須於完成日期後三個月以現金支付予BVI Holdings。

代價乃經駿碼科技(香港)及BVI Holdings公平磋商後釐定，並經參考(i)本集團與使用知識產權相關的未來前景；(ii)初步估值；及(iii)下文「進行收購事項的理由及裨益以及更改所得款項用途」一節所列資料。

代價已決定以本集團的內部資源及銀行借款撥資。

在評估知識產權市場價值是否公平合理時，董事曾審閱估值及就達成知識產權市場價值時所採納方法以及所用的基準及主要假設及量化輸入數據與獨立估值師討論。董事自獨立估值師得悉，獨立估值師在估值中採納成本法，估值乃參考已產生的歷史研究及開發成本編製，乃由於獨立估值師認為市場法及收入法並不合適，因為(i)缺乏與知識產權可資比較的現有市場交易；及(ii)收入法需要就較長時間跨度進行大量假設。

---

## 董事會函件

---

董事亦曾審閱估值所採納的假設，並獲悉估值所採納的關鍵假設乃就處於相若階段的相若資產估值時所常用者。董事已進一步(i)自第三方供應商獲得製造供應的最新報價；(ii)就近期勞工成本對公開資料進行調查；及(iii)就開發知識產權所產生的成本審閱BVI Holdings提供的董事會會議記錄、項目報告及財務資料。董事並無發現與估值的量化輸入數據相關的異常情況。就此而言，董事認為估值所採納的關鍵假設、量化輸入數據及方法乃屬公平合理。

董事認為該協議的條款及條件(包括代價)按照正常商業條款進行，屬公平合理，符合本公司及其股東整體利益。

### 該協議的條件及完成

該協議須待以下條件達成後方可完成：

- (i) 駿碼科技(香港)信納對知識產權的盡職審查結果；
- (ii) 駿碼科技(香港)信納估值；
- (iii) 駿碼科技(香港)已就銀行融資獲得一間香港持牌銀行批准；及
- (iv) 本公司已獲得董事會(包括獨立非執行董事)及獨立股東於股東特別大會上的批准，以訂立該協議及據此擬進行的交易。

如上述條件未能於截止日期前達成，除若干仍然有效的條款外，該協議將終止並成為不可強制執行，惟有關終止將不得損害任何一方就另外一方先前違反該協議的權利及補救措施，且就收購事項向BVI Holdings支付的任何部分代價將於截止日期後五個營業日內退還予駿碼科技(香港)。

於最後實際可行日期，上文所載的條件(i)及(ii)已獲達成。

### 更改股份發售所得款項用途

於最後實際可行日期，未動用的所得款項淨額約為23.1百萬港元，佔所得款項淨額約27.7%。

## 董事會函件

由於業務環境瞬息萬變，本集團將繼續為其產品開發及／或尋求新技術，以把握最新趨勢帶來的新機遇，尤其是增加半導體及Mini-LED顯示器封裝相關業務的市場份額。因此，董事會已決定分配更多資源以提供優質先進的產品，滿足本集團客戶對半導體封裝相關封裝膠不斷變化的需求。為此，於2023年6月14日，本公司刊發公佈（「公佈」），報告董事會已決定重新分配未動用的所得款項淨額至研發以用於收購知識產權。更改所得款項淨額用途的詳情如下：

	於先前 公佈日期 未動用經修訂 所得款項淨額 百萬港元	直至 公佈日期 已動用 所得款項淨額 百萬港元	直至 公佈日期 未動用 所得款項淨額 百萬港元	更改所得 款項淨額分配 百萬港元	直至最後 實際可行 日期未動用 經修訂所得 款項淨額 百萬港元	建議 應用未動用 所得款項 淨額的預期 時間表
<b>擴充產能及升級生產設施</b>						
– 收購或投資鍵合線業務或 相關業務	19.4	–	19.4	(19.4)	–	–
– 採購用於加強質量控制的 機器及設備	0.7	(0.7)	–	–	–	–
– 採購用於新生產線的機器及 設備以及升級生產設施	1.8	(1.0)	0.8	(0.8)	–	–
<b>投放研發資源</b>						
– 收購知識產權	10.2	(10.2)	–	23.1	23.1	由最後 實際可行 日期起至 2023年 12月31日
– 採購用於改善研發的機器及 設備	3.0	(0.1)	2.9	(2.9)	–	–
– 委聘研發項目的外部顧問	1.5	(1.5)	–	–	–	–
<b>增加銷售及營銷活動</b>	2.3	(2.3)	–	–	–	–
<b>總計</b>	38.9	(15.8)	23.1	–	23.1	

根據上表，董事會已決定將原用於(i)收購或投資鍵合線業務或相關業務；(ii)採購用於新生產線的機器及設備以及升級生產設施；及(iii)採購用於改善研發的機器及設備的未動用所得款項淨額約23.1百萬港元，重新分配至收購知識產權（即收購事項）。

### 進行收購事項的理由及裨益以及更改所得款項用途

本集團主要從事開發、製造及銷售半導體封裝材料。

#### 收購事項

根據本公司截至2022年12月31日止年度的年報（「**2022年年報**」），本公司錄得總收益約217.9百萬港元，其中約106.0百萬港元來自銷售鍵合線，較2021年同期減少約56.5百萬港元或34.8%。有關減少主要由於國內疫情。同時，銷售封裝膠的收益由截至2021年12月31日止年度約76.6百萬港元增加約23.8百萬港元至截至2022年12月31日止年度約100.4百萬港元。封裝膠銷售增加主要由於國內市場需求增長。毛利率由截至2021年12月31日止年度約23.4%上升至截至2022年12月31日止年度約26.6%，主要由於毛利率較高的封裝膠產品的銷售增加。

本集團一直以來的業務戰略為通過提供優質先進的產品滿足客戶不斷變化的需求，從而繼續擴大客戶群。本集團持續開發及／或尋求新技術，為客戶提供更優質的產品，以應付其需求並加強其於LED行業的競爭能力。本集團亦考慮將客戶群從商用擴大至家電產品。擴大後的應用範圍將不僅包括機場及商場LED顯示屏等商業用途，亦將包括Mini-LED電視等家電產品。

中國Mini-LED市場近年來增長迅速。更多配備Mini-LED的家電產品相繼推出，包括電視及遊戲顯示器等。與傳統LED相比，Mini-LED體積更小，可更精準地控制顯示器的背光。Mini-LED提高對比度及亮度，提供更佳畫質。Mini-LED亦較傳統LED更節能，故可延長便攜式設備的電池壽命。預期未來Mini-LED將廣泛用於國內電子產品的生產。

鑑於Mini-LED市場持續增長，董事認為，收購事項將使本集團能夠把握Mini-LED行業預期市場增長所帶來的機遇，並通過豐富其產品結構保持本集團在封裝膠市場的競爭力。

利用知識產權，本集團可為客戶生產出兩種類型的封裝劑，用於兩種類型的Mini-LED封裝。

COB封裝技術為製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術。COB封裝技術可採用適用於Mini-LED封裝的環氧樹脂瞬間固化技術，並具有高韌性、低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。

FC-BGA封裝技術為製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術。FC-BGA封裝技術通過改變樹脂、促進劑及多元醇的類型及結構，改進用於封裝的環氧樹脂成型材料，並具有低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點，適用於Mini-LED模組封裝的注塑工藝。

鑒於LED行業技術的不斷變化以及電子產品的日益小型化，不斷加強及開發封裝膠極為重要。然而，開發一種新型封裝膠可能會耗費大量成本及時間。基於知識產權的新型封裝膠是一套完整及完全開發技術，將使本集團可在緊接該協議完成後立即開始生產新型封裝膠。因此，董事認為，收購事項可以節省本集團的時間與精力，使其無需自行開發具有類似於知識產權特性的封裝膠。

### 更改所得款項用途

董事認為，在保持在中國鍵合線市場競爭力的同時，本集團應將更多資源分配予封裝膠市場的發展。為使本集團更佳地利用財務資源，本集團已決定將未動用所得款項淨額約23.1百萬港元重新分配至本集團的研發活動。

為進一步提高本集團在封裝膠市場的競爭力，本集團已決定將重新分配的所得款項淨額用於收購知識產權。董事認為，有關新封裝膠技術的收購事項將節省本集團用於自身研發的時間與精力，並使本集團能夠立即開始生產規格更佳、成本更低的新產品，以滿足Mini-LED市場日益增長的需求。

鑒於上述情況，董事認為，上述更改未動用所得款項淨額有利於本集團的長期業務發展，且亦是對未動用所得款項淨額更恰當的利用。董事會將以本公司及其股東的利益為重，密切關注未動用所得款項淨額的使用情況。董事會確認，本公司在招股章程及已發表季度、中期及年度報告中所述的本集團的業務性質沒有重大變化。董事會認為，建議更改所得款項淨額的用途不會對本集團的運營及業務產生任何重大不利影響，並且符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 收購事項對本公司盈利、資產及負債的影響

### 盈利

預期完成該協議不會對本集團盈利造成重大影響。

### 資產及負債

於2022年12月31日，本集團的經審核資產總值約為311.7百萬港元。收購事項完成後，知識產權將確認為本集團的非流動資產，賬面值約為38.0百萬港元（即代價），而本集團將以現金及銀行借款結清收購事項的代價。因此，預期本集團的總資產將會改善及銀行借款將會增加。

### BVI HOLDINGS的資料

BVI Holdings的主要業務為投資控股。於最後實際可行日期，其由周博士最終擁有40%，及由周教授最終擁有60%。

### GEM上市規則的含義

BVI Chows持有BVI Holdings的100%全部已發行股本，並由執行董事、本公司執行主席及控股股東周博士直接及實益擁有40%，及由執行董事及控股股東周教授直接及實益擁有60%；及BVI Holdings持有357,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本約50.6%。因此，BVI Holdings為本公司的關連人士，因此，根據GEM上市規則第20章，收購事項構成本公司的關連交易。

周教授及周博士於收購事項擁有重大權益。周教授及周博士已就董事會批准該協議及據此擬進行的交易（包括收購事項）的決議案放棄投票。由於BVI Holdings為該協議及據此擬進行的交易的訂約方，其須於股東特別大會上就批准該協議及據此擬進行的交易的相關決議案放棄投票。

由於有關該協議的最高適用比率（定義見GEM上市規則）超過25%但低於100%，根據GEM上市規則第19章，收購事項亦構成本公司的重大交易，須遵守申報、公佈及股東批准的規定。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就（其中包括）該協議項下擬進行的交易（包括收購事項）的條款向股東提供意見。本公司已委任衍丰企業融資為獨立財務顧問，向獨立董事委員會提供推薦建議。

### 股東特別大會及受委代表安排

本公司謹訂於2023年8月2日(星期三)下午二時三十分假座香港新界白石角香港科學園二期尚湖樓2樓208室召開股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。於股東特別大會上，將提呈決議案以考慮及酌情批准該協議及其項下擬進行之交易。

隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請盡快按隨附的代表委任表格所載之指示填妥該表格，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時內送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

### 於股東特別大會上進行表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠信原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。因此，股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的決議案應由股東以投票方式進行表決。

### 推薦意見

董事認為，該協議及其項下擬進行之交易(包括收購事項)的條款對本公司及股東而言屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的決議案，以批准該協議及其項下擬進行的交易(包括收購事項)。

### 其他資料

謹請垂注(i)本通函第14至15頁所載的獨立董事委員會函件，當中載有獨立董事委員會就該協議及其項下擬進行的交易向股東提出的建議；(ii)本通函第16至29頁所載的獨立財務顧問函件，當中載有獨立財務顧問就該協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及股東提供的意見，連同其在作出意見時考慮的主要因素及理由；及(iii)本通函附錄所載之其他資料。

### 語言

就詮釋而言，本通函之中英文本如有歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
駿碼半導體材料有限公司  
執行主席兼執行董事  
周博軒  
謹啟

2023年7月18日

---

## 獨立董事委員會函件

---

以下為獨立董事委員會就該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)向股東提出的建議以載入本通函的函件全文，該函件載有其就該協議及據此擬進行的交易向股東提出的意見及建議。



敬啟者：

### 有關收購知識產權的重大關連交易

吾等謹此提述本公司於2023年7月18日向股東刊發的通函(「通函」)，本函件構成其中一部分。除文義另有所指外，本函件的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，以考慮該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)，並就該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)的條款對股東而言是否公平合理、是否按正常商業條款或更佳條款進行並符合本公司及股東之整體利益，並就應採取的投票行動向股東提供意見。衍丰企業融資有限公司已獲委任就此向獨立董事委員會及股東提供意見。

### 推薦建議

吾等謹請閣下垂注通函第5至13頁所載的董事會函件及通函第16至29頁所載的衍丰企業融資有限公司函件，當中載有其就該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)致獨立董事委員會及股東的意見，以及衍丰企業融資有限公司在達致其推薦建議時所考慮的主要因素及理由。

---

## 獨立董事委員會函件

---

經考慮衍丰企業融資有限公司的意見後，吾等認為該協議及據此擬進行的交易（包括收購事項）的條款對股東而言屬公平合理、乃按正常商業條款進行並符合本公司及股東之整體利益。因此，吾等建議股東投票贊成擬於股東特別大會上提呈的決議案，以批准該協議及據此擬進行的交易（包括收購事項）。

此 致

列位股東 台照

獨立非執行董事  
吳宏偉教授

獨立董事委員會  
獨立非執行董事  
戴進傑先生

獨立非執行董事  
潘禮賢先生

謹啟

2023年7月18日

以下為衍丰企業融資有限公司的意見函件全文，乃為載入本通函而編製，當中載有其就該協議及據此擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見。



衍丰企業融資有限公司  
香港中環  
雲咸街73號  
雲山大廈14樓1402室

敬啟者：

## 有關收購知識產權的重大關連交易

### 緒言

吾等謹此提述吾等獲委任為獨立董事委員會及獨立股東就該協議及據此擬進行的交易的條款的獨立財務顧問，有關詳情載於 貴公司日期為2023年7月18日的通函（「通函」）內的董事會函件（「董事會函件」），本函件構成通函的一部分。除文義另有所指外，本函件中所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述 貴公司日期為2023年6月14日的公佈，於2023年6月14日，駿碼科技（香港）與BVI Holdings訂立該協議，據此，駿碼科技（香港）同意購買而BVI Holdings（作為實益擁有人）同意出售知識產權，總代價為38.0百萬港元，較由獨立估值師編製有關知識產權的初步估值折讓約4.3%。

於最後實際可行日期，(i)BVI Chows持有BVI Holdings的100%全部已發行股本，並由執行董事、 貴公司執行主席及控股股東周博士直接及實益擁有40%，及由執行董事及控股股東周教授直接及實益擁有60%；及(ii)BVI Holdings持有357,000,000股股份，佔 貴公司全部已發行股本約50.6%。因此，BVI Holdings為 貴公司的關連人士，因此，根據GEM上市規則第20章，收購事項構成 貴公司的關連交易。

---

## 獨立財務顧問函件

---

由於有關該協議的最高適用比率(定義見GEM上市規則)超過25%但低於100%，根據GEM上市規則第19章，收購事項亦構成 貴公司的重大交易，須遵守申報、公佈及股東批准的規定。

周教授及周博士於收購事項擁有重大權益。周教授及周博士已就董事會批准該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)的決議案放棄投票。由於BVI Holdings為該協議及據此擬進行的交易的訂約方，其須於股東特別大會上就批准該協議及據此擬進行的交易的相關決議案放棄投票。

吾等於過往兩年概無擔任 貴公司的獨立財務顧問，且並無向 貴公司提供任何其他服務。於最後實際可行日期，吾等並不知悉吾等與 貴公司或任何其他訂約方之間有任何可合理視為妨礙吾等就收購事項擔任獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問的獨立性(定義見GEM上市規則第17.96條)的關係或利益。吾等與 貴公司、其附屬公司、其聯繫人或彼等各自的主要股東或聯繫人或收購事項的任何其他訂約方並無關連，因此符合資格就該協議及據此擬進行的交易提供獨立意見及推薦建議。除就是次獲委任為獨立財務顧問而應付予吾等的正常專業費用外，概無存在任何安排而使吾等將據此自 貴公司、其附屬公司、其聯繫人或彼等各自的主要股東或聯繫人或可合理視為與吾等的獨立性有關的任何其他訂約方收取任何費用。

### 獨立董事委員會

由全體獨立非執行董事(即吳宏偉教授、潘禮賢先生及戴進傑先生)組成的獨立董事委員會已告成立，經考慮吾等的推薦建議後，以就該協議的條款以及該協議及據此擬進行的交易是否屬公平合理，並符合 貴公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。

作為獨立財務顧問，吾等的角色為就該協議及據此擬進行的交易就獨立股東而言是否屬公平合理及符合 貴公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供獨立意見。

## 吾等意見的基礎

於達致吾等的意見及推薦建議時，吾等已依賴本通函所載或提述及／或 貴公司及 貴集團管理層向吾等提供與 貴集團營運、財務狀況及前景有關的陳述、資料、意見及聲明。吾等假設吾等獲提供的有關資料及任何聲明於最後實際可行日期在各重大方面均屬真實、準確及完備，並認為吾等所得的資料足以令吾等達致本函件所載的意見及推薦建議並為吾等依賴有關資料提供理據。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，彼等於本通函中表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本通函並無遺漏其他重大事實，以致本通函所載由彼等作出的任何有關陳述在各重大方面有所誤導。吾等並無理由懷疑吾等獲提供資料的真實性或準確性，亦無理由相信有任何重大資料遭遺漏或隱瞞。

吾等的審閱及分析乃基於（其中包括） 貴集團提供的資料，包括本通函、本通函附錄二所載由獨立估值師編製的估值報告（「**估值報告**」）及若干來自公開渠道的若干已刊發資料，包括但不限於 貴公司截至2022年12月31日止年度的年報（「**2022年年報**」）。吾等亦已就估值報告的條款和採納的基準及假設以及進行收購事項的理由及裨益與董事及 貴公司管理層進行討論。然而，就是次委聘而言，吾等並未對 貴集團的業務、事務及財務狀況進行任何深入獨立調查，亦無獨立核實所獲提供的資料。

## 所考慮的主要因素及理由

吾等就收購事項達致向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見及推薦建議時，已考慮以下主要因素及理由：

### 1. 貴集團的背景及財務資料

#### (a) 貴集團的背景

誠如2022年年報所載， 貴集團總部位於香港並在中國汕頭設有生產設施，為專門從事開發、製造及銷售鍵合線及封裝膠的知名半導體封裝材料製造商。截至2022年12月31日止年度， 貴集團繼續向超過600名客戶（包括主要位於中國的知名LED、相機模組及IC製造商）直接銷售產品。

(b) 貴集團的財務表現

貴集團摘自2022年年報分別截至2021年12月31日（「2021財年」）及2022年12月31日（「2022財年」）止兩個財政年度的財務表現概述如下：

	2021財年 概約千港元 (經審核)	2022財年 概約千港元 (經審核)
<b>收益</b>		
(i) 鍵合線	162,494	105,955
(ii) 封裝膠	76,622	100,372
(iii) 其他	9,923	11,532
<b>總收益</b>	<b>249,039</b>	<b>217,859</b>
<b>毛利</b>	<b>58,341</b>	<b>57,992</b>
<b>除稅前溢利</b>	<b>10,507</b>	<b>14,211</b>
<b>年內溢利</b>	<b>6,849</b>	<b>8,640</b>

貴集團的收益主要指來自其主要產品（即鍵合線及封裝膠）的收入。誠如2022年年報所載，貴集團於2022財年錄得收益約217.9百萬港元，較2021財年的約249.0百萬港元減少約12.5%。鍵合線產品於2022財年的收益約為106.0百萬港元，較2021財年的約162.5百萬港元減少約56.5百萬港元或34.8%，而封裝膠產品於2022財年則錄得收益約100.4百萬港元，較2021財年的約76.6百萬港元增加約23.8百萬港元或31.1%。兩種產品的收益變動乃由於貴集團對產品組合進行戰略性調整以盡量提高股東回報，因此，毛利率較高的封裝膠產品於2022財年的銷售增加。

儘管貴集團於2022財年的收益減少，貴集團於2022財年的毛利維持於約58.0百萬港元，而2021財年則約為58.3百萬港元。毛利率由2021財年的約23.4%上升至2022財年的約26.6%。

貴集團淨溢利由2021財年的約6.8百萬港元上升約26.5%至2022財年的約8.6百萬港元。淨溢利增加主要由於上述產品組合改善及新產品的強勁銷售表現使貴集團的毛利率有所提高；以及由於人民幣貶值產生的外匯收益淨額。

## 獨立財務顧問函件

### (c) 貴集團的財務狀況

貴集團摘自2022年年報分別於2021年12月31日及2022年12月31日的綜合財務狀況表載列如下：

	於2021年 12月31日 概約千港元 (經審核)	於2022年 12月31日 概約千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>		
廠房及設備	41,861	41,301
使用權資產	13,767	11,938
無形資產	71,188	69,076
就購買廠房及設備以及 無形資產支付的按金	2,545	5,440
租賃按金	572	562
遞延稅項資產	2,103	1,776
<b>總非流動資產</b>	<b>132,036</b>	<b>130,093</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	35,519	33,664
貿易應收款項及應收票據	129,001	105,302
其他應收款項、預付款項及按金	2,551	2,399
銀行存款	17,536	19,145
銀行結餘及現金	15,178	21,070
<b>總流動資產</b>	<b>199,785</b>	<b>181,580</b>
<b>總資產</b>	<b>331,821</b>	<b>311,673</b>
<b>流動負債</b>		
貿易及其他應付款項	25,136	23,614
合約負債	579	718
租賃負債	3,373	5,238
遞延收入	1,436	1,324
應付稅項	3,869	7,325
銀行借款	23,610	26,280
銀行透支	12,231	5,640
<b>總流動負債</b>	<b>70,234</b>	<b>70,139</b>
<b>非流動負債</b>		
租賃負債	13,106	9,321
遞延收入	5,296	3,560
<b>總非流動負債</b>	<b>18,402</b>	<b>12,881</b>
<b>總負債</b>	<b>88,636</b>	<b>83,020</b>
<b>資產淨值</b>	<b>243,185</b>	<b>228,653</b>

如上表所示，吾等注意到，於2021年12月31日至2022年12月31日期間，貴集團的總資產（包括非流動資產及流動資產）並無按年重大增加或減少。

誠如2022年年報所載，儘管2022財年COVID-19陰霾未散，全球地緣政治局勢持續複雜，貴集團仍將繼續執行有效的業務戰略，並通過提供優質先進的產品滿足客戶不斷變化的需求，從而擴大客戶群。就Mini-LED顯示器而言，貴集團將持續開發及／或尋求新技術，為客戶提供更優質的產品，以應付客戶的需求並加強他們的競爭能力。貴集團同時正在考慮將客戶群從商用擴大至家用市場。應用範圍不再局限於機場及商場LED顯示屏等商業用途，亦將包括家用電子產品。

根據董事會函件，貴集團一直以來的業務戰略為通過提供優質先進的產品滿足客戶不斷變化的需求，從而繼續擴大客戶群。由於中國Mini-LED市場近年來增長迅速，利用知識產權，貴集團可為客戶生產出兩種類型的封裝劑，用於兩種類型的Mini-LED封裝。因此，吾等認為收購事項符合貴集團於2022年年報所述的業務戰略。

## 2. 該協議的主要條款

該協議的主要條款載列如下：

### 日期

2023年6月14日

### 訂約方

- (i) 駿碼科技（香港），作為買家；及
- (ii) BVI Holdings，作為賣家。

### 買賣知識產權

根據該協議的條款及條件，BVI Holdings作為實益擁有人出售知識產權予駿碼科技（香港），駿碼科技（香港）將向BVI Holdings購買知識產權，且不附帶任何產權負擔。

## 知識產權

知識產權包括COB封裝技術及FC-BGA封裝技術。

COB封裝技術為製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術。董事會認為，COB封裝技術可採用用於Mini-LED行業的環氧樹脂瞬間固化技術。COB封裝技術由BVI Holdings開發，具有高韌性、低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。COB封裝技術適用於小間距RGB Mini-LED模組。

FC-BGA封裝技術為製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術。董事會認為，FC-BGA封裝技術通過改變樹脂、促進劑及多元醇的類型及結構，可改進用於封裝的環氧樹脂成型材料及提高成型工藝的持續性，並具有低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點，適用於Mini-LED模組封裝的注塑工藝。

## 代價及付款

根據該協議，收購COB封裝技術及FC-BGA封裝技術的代價分別為28.2百萬港元及9.8百萬港元。因此，代價應為38.0百萬港元。

COB封裝技術及FC-BGA封裝技術的估值乃由獨立估值師於2023年4月30日（「估值日期」）按照國際估值準則理事會頒佈的國際估值準則根據成本法估值，分別約為29.5百萬港元及10.2百萬港元。估值所用的關鍵假設及所採納方法的詳情及基準載於本通函附錄二的估值報告。代價較估值折讓約4.3%。

代價應由駿碼科技（香港）以下列方式支付：

- (i) 12.0百萬港元代價已於該協議簽署日期支付予BVI Holdings作為按金；
- (ii) 12.0百萬港元代價須於股東特別大會上獲得獨立股東批准及就銀行融資獲得一間香港持牌銀行批准後以現金支付予BVI Holdings；

(iii) 12.0百萬港元代價須於完成後以現金支付予BVI Holdings；及

(iv) 餘下2.0百萬港元代價須於完成日期後三個月以現金支付予BVI Holdings。

代價乃經駿碼科技(香港)及BVI Holdings公平磋商後釐定，並經參考(i) 貴集團與使用知識產權相關的未來前景；(ii)初步估值；及(iii)董事會函件中「進行收購事項的理由及裨益以及更改所得款項用途」一節所列資料。

代價已決定以 貴集團的內部資源及銀行借款撥資。

在評估知識產權市場價值是否公平合理時，董事曾審閱估值及就達成知識產權市場價值時所採納方法以及所用的基準及主要假設及量化輸入數據與獨立估值師討論。董事自獨立估值師得悉，獨立估值師在估值中採納成本法，估值乃參考已產生的歷史研究及開發成本編製，乃由於獨立估值師認為市場法及收入法並不合適，因為(a)缺乏與知識產權可資比較的現有市場交易；及(b)收入法需要就長期水平進行大量假設。

董事亦曾審閱估值所採納的假設，並獲悉估值所採納的關鍵假設乃就處於相若階段的相若資產估值時所常用者。董事已進一步(i)自第三方供應商獲得製造供應的最新報價；(ii)就近期勞工成本對公開資料進行調查；及(iii)就開發知識產權所產生的成本審閱BVI Holdings提供的董事會會議記錄、項目報告及財務資料。董事並無發現與估值的量化輸入數據相關的異常情況。就此而言，董事認為估值所採納的關鍵假設、量化輸入數據及方法乃屬公平合理。

董事認為該協議的條款及條件(包括代價)按照正常商業條款進行，屬公平合理，符合 貴公司及其股東整體利益。

### 該協議的條件及完成

該協議須待以下條件達成後方可完成：

- (i) 駿碼科技(香港)信納對知識產權的盡職審查結果；
- (ii) 駿碼科技(香港)信納估值；
- (iii) 駿碼科技(香港)已就銀行融資獲得一間香港持牌銀行批准；及
- (iv) 貴公司已獲得董事會(包括獨立非執行董事)及獨立股東於股東特別大會上的批准，以訂立該協議及據此擬進行的交易。

如上述條件未能於截止日期前達成，除若干仍然有效的條款外，該協議將終止並成為不可強制執行，惟有關終止將不得損害任何一方就另外一方先前違反該協議的權利及補救措施，且就收購事項向BVI Holdings支付的任何部份代價將於截止日期後五個營業日內退還予駿碼科技(香港)。

於最後實際可行日期，上文所載的條件(i)及(ii)已獲達成。

### 3. 知識產權的估值

誠如董事會函件所披露，代價乃經駿碼科技(香港)及BVI Holdings公平磋商後釐定，並經參考(其中包括)由獨立估值師於估值日期根據成本法估值的COB封裝技術及FC-BGA封裝技術知識產權的評估市值，分別約為29.5百萬港元及10.2百萬港元。估值詳情及估值報告載於通函附錄二。

為進行盡職審查，吾等已審閱及查詢(i)獨立估值師與貴公司的委聘條款；(ii)獨立估值師與編製估值報告有關的背景及資格；及(iii)獨立估值師為編製估值報告所採取的步驟及盡職審查措施。根據獨立估值師提供的資料以及吾等與其進行的討論，吾等知悉，就知識產權進行估值的獨立估值師負責人員陳銘傑先生為香港會計師公會及澳大利亞會計師公會的資深會員，並於會計、審計、企業諮詢及估值方面擁有逾20年經驗。此外，獨立估值師曾為中國、香港、新加坡及美國境內不同行業的眾多已上市及現正上市公司提供廣泛估值服務。因此，吾等信納獨立估值師編製估值報告的資格。

評估收購事項代價是否屬公平合理時，吾等已審閱估值報告且經吾等與獨立估值師進行進一步討論後，吾等知悉獨立估值師經考慮估值報告所述的以下理由後，採納成本法達致知識產權的估值：

### (1) 收入法

收入法是將擁有權之預期定期利益轉換為價值指標。該方法乃基於知情買方不會就有關項目支付超過相等於具有相若風險概況之相同或大致相若項目之預期未來利益(收益)之現值金額的原則。該方法考慮未來溢利之預期估值，並有大量的經驗數值及理論解析可用作進行預期未來現金流的現值計算。然而，該方法依賴較長時間跨度內之大量假設，而結果可能受若干輸入數據之較大影響。而且，其僅可呈現單一情況。

### (2) 市場法

市場法考慮近期就類似資產支付之價格，並對有關市價作出調整以反映所評估資產相對於市場可資比較資產在狀況及用途方面的差異。具備既有二級市場的資產，可採用此方法進行估值。使用該方法的好處是簡單、明確及快捷，且只需作出少量假設甚或毋須作出假設。另外，該方法使用公開可得輸入數據，故亦具備客觀性。然而，須注意有關可資比較資產之價值中存在固有假設，故有關輸入數據中亦含有隱藏假設。尋找可資比較資產亦非易事。此外，該方法完全依賴有效市場假說。

### (3) 成本法

成本法根據類似資產之現行市價，考慮重製或重置所評估資產至全新狀況之成本，並就應計折舊或殘舊狀況(不論因外觀、功能或經濟方面而導致)作出撥備。成本法一般能為並無已知二級市場的資產提供最可靠的價值指標。雖然該方法具有簡單透明的優點，但並未直接納入有關標的資產所帶來經濟利益之資料。

獨立估值師認為，收入法並不合適，因為此方法需要知識產權之詳細資料及長期財務預測，但並無該等資料以及客觀的證明文件和資訊。市場法並不合適，因為其要求與知識產權可資比較的市場交易作為價值指標。然而，獨立估值師尚未發現任何與知識產權可資比較的當前市場交易。

獨立估值師已採用成本法，同時考慮知識產權的性質及背景。根據估值報告，貴公司已向獨立估值師解釋，在其經營的行業(即半導體封裝)中，任何新技術的研發通常至少要在其可能的部署前3至5年進行規劃。貴公司進一步告知，市場需求是部署新技術的一個重要因素。知識產權於2015年完成開發時，市場上現有產品的各自產品生命週期尚未終結，Mini-LED尚未開始在市場上普及，仍未達到大規模生產階段。Mini-LED直至近期才在市場上變得更加普及，部分客戶向貴公司諮詢Mini-LED產品，尤其是與知識產權相關的產品。

吾等亦已審閱通函附錄二所載估值報告中的評估假設，確認該等假設屬公平合理，並適用於知識產權的估值。

吾等已就上述假設的適用性向獨立估值師查詢，吾等知悉該等假設於其他估值活動中普遍及一貫採用，並符合市場慣例。因此，吾等認為，估值中採用的假設屬合理。於與獨立估值師進行討論期間，吾等並無發現任何重大因素令吾等對估值方法的公平性及合理性以及達致知識產權評估價值所採用的主要基準及假設產生懷疑。

誠如獨立估值師所告知，使用成本法對知識產權進行的估值乃根據與知識產權開發相關的直接材料、製造供應及直接勞工的歷史成本估計得出，然後根據實際項目開發期與估值日期之間的價格水平變動進行調整。

吾等已審查知識產權的直接材料、製造供應及直接勞工的歷史成本的基本計算及估計。根據吾等對基本計算的審查，吾等注意到(i)直接材料的歷史成本乃基於董事會會議記錄及自賣家獲得的知識產權研發記錄中的資料計算；(ii)製造供應的歷史成本乃基於上述董事會會議記錄所附的設備清單以及設備的估計折舊計算，而該估計折舊乃根據自獨立設備供應商獲得的有關設備採購報價並根據設備的使用時長(即項目實際開發期間)進行調整按直線法計算得出；及(iii)直接勞工的歷史成本乃基於上述知識產權研發記錄中所載開發知識產權的研究人員數目以及從多個薪酬統計來源獲得的薪酬資料的平均值計算得出。按上述三個參數(直接材料、製造供應及直接勞工)分類的COB封裝技術及FC-BGA封裝技術市場價值，以及估值所用的量化輸入數據(摘錄自吾等已審查的基本計算)載於通函附錄二的估值報告。

經審查估值基礎及基本計算（包括估值所用的量化輸入數據）並與獨立估值師進行討論後，吾等認為上述方法為達致知識產權市場價值的合理方法。

根據吾等對估值報告的審查以及與獨立估值師就以下各項進行的討論：(i) 獨立估值師的工作範圍及經驗；(ii) 採用成本法對知識產權進行估值的理由及適當性；(iii) 估值報告所採用的基礎、假設及方法；及(iv) 獨立估值師進行的估值工作，吾等並無注意到任何事項令吾等對編製估值報告的公平性及合理性產生懷疑。鑑於上述各項，吾等認為獨立估值師進行的估值以及估值報告所採用的基礎、假設和方法乃屬適當。

#### 4. 進行收購事項的理由及裨益

根據董事會函件，貴集團一直以來的業務戰略為通過提供優質先進的產品滿足客戶不斷變化的需求，從而繼續擴大客戶群。貴集團持續開發及／或尋求新技術，為客戶提供更優質的產品，以應付其需求並加強其於LED行業的競爭能力。貴集團亦考慮將客戶群從商用擴大至家電產品。擴大後的應用範圍將不僅包括機場及商場LED顯示屏等商業用途，亦將包括Mini-LED電視等家電產品。中國Mini-LED市場近年來增長迅速。更多配備Mini-LED的家電產品相繼推出，包括電視及遊戲顯示器等。與傳統LED相比，Mini-LED體積更小，可更精準地控制顯示器的背光。Mini-LED提高對比度及亮度，提供更佳畫質。Mini-LED亦較傳統LED更節能，故可延長便攜式設備的電池壽命。預期未來Mini-LED將廣泛用於國內電子產品的生產。

鑑於Mini-LED市場持續增長，董事認為，收購事項將使貴集團能夠把握Mini-LED行業預期市場增長所帶來的機遇，並通過豐富其產品結構保持貴集團在封裝膠市場的競爭力。

利用知識產權，貴集團可為客戶生產出兩種類型的封裝劑，用於兩種類型的Mini-LED封裝。

COB封裝技術為製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術。COB封裝技術可採用適用於Mini-LED封裝的環氧樹脂瞬間固化技術，並具有高韌性、低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。

FC-BGA封裝技術為製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術。FC-BGA封裝技術通過改變樹脂、促進劑及多元醇的類型及結構，改進用於封裝的環氧樹脂成型材料，並具有低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點，適用於Mini-LED模組封裝的注塑工藝。

鑒於LED行業技術的不斷變化以及電子產品的日益小型化，不斷加強及開發封裝膠極為重要。然而，開發一種新型封裝膠可能會耗費大量成本及時間。基於知識產權的新型封裝膠是一套完整及完全開發技術，將使貴集團可在緊接收購事項完成後立即開始生產新型封裝膠。因此，董事認為，收購事項可以節省貴集團的時間與精力，使其無需自行開發具有類似於知識產權特性的封裝膠。

吾等已審閱貴公司提供的文件，包括第三方行業專家對LED技術進行的行業分析以及知識產權資料。根據全球最大中文學術內容資源供應商中國學術期刊電子出版社(<http://www.cnki.net>)於2023年2月發表的文章，三星、海信、小米、TCL、索尼、飛利浦、康佳及創維等主要電視生產商均已開發Mini-LED電視及顯示屏。與傳統LED相比，Mini-LED更輕、成本更低及節能性能更高。採用Mini-LED技術的TFT-LCD電視成本為OLED電視的60%至80%，惟兩款產品的顯示質量相似。為滿足客戶對Mini-LED的技術要求以及符合行業技術發展的趨勢，進行收購事項後，知識產權將為貴集團提供為客戶生產Mini-LED封裝用封裝劑的關鍵技術，而無需花費時間進行進一步研發。

經考慮(i) 貴集團自行開發知識產權可能會耗費大量成本及時間；(ii)收購事項使貴集團能夠立即把握Mini-LED行業預期市場增長所帶來的機遇；(iii)收購事項的估值屬公平合理；及(iv)代價較估值折讓約4.3%，吾等認為收購事項對貴公司及股東整體而言屬公平合理。

## 5. 收購事項的財務影響

根據董事會函件，預期完成該協議不會對貴集團盈利造成重大影響。

---

## 獨立財務顧問函件

---

於2022年12月31日，貴集團的經審核資產總值約為311.7百萬港元。收購事項完成後，知識產權將確認為貴集團的非流動資產，賬面值約為38.0百萬港元(即代價)，而貴集團將以內部資源及銀行借款結清收購事項的代價。因此，預期(i)總資產將按代價及結算部分代價所用的內部資源的差額增加；及(ii)銀行借款將按結算餘下代價所提取的金額增加。

### 推薦建議

經考慮上述主要因素及理由，尤其是(i)該協議的主要條款；(ii)估值；及(iii)進行收購事項的理由及裨益，吾等認為該等條款乃按正常商業條款進行，對貴公司及獨立股東而言屬公平合理並符合貴公司及股東之整體利益。

因此，吾等建議獨立董事委員會推薦獨立股東投票贊成批准該協議及據此擬進行的交易的決議案。

此 致

駿碼半導體材料有限公司  
獨立董事委員會及列位獨立股東 台照

代表  
衍丰企業融資有限公司  
董事總經理  
梁悅兒  
謹啟

2023年7月18日

梁悅兒女士為證監會註冊持牌人士及衍丰企業融資有限公司的負責人員，可從事證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。彼於機構融資行業積逾20年經驗，曾為多項香港上市公司交易提供獨立財務顧問服務。

## 1. 本集團的財務資料

本集團截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度各年的財務資料詳情於下列文件內披露，該等文件乃於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nichetech.com.hk)刊載。

截至2020年12月31日止年度之年報(第52至122頁)：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/0330/2021033000739\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/0330/2021033000739_c.pdf)

截至2021年12月31日止年度之年報(第68至142頁)：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2022/0330/2022033000748\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2022/0330/2022033000748_c.pdf)

截至2022年12月31日止年度之年報(第72至148頁)：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2023/0330/2023033000866\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2023/0330/2023033000866_c.pdf)

## 2. 債務

於2023年5月31日(即本通函付印前就本債務聲明而言的最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團的債務如下：

### 銀行借款

於2023年5月31日，本集團之銀行借款約為47,980,000港元，包括以下各項：

	千港元
無抵押有擔保之銀行借款	25,992
有抵押無擔保之銀行借款	21,988
	<u>47,980</u>

銀行借款以本集團若干應收票據作抵押。若干銀行借款由本公司、若干董事及本公司其中一間附屬公司提供擔保。

### 租賃負債

本集團就若干租賃物業、汽車及設備的租賃產生租賃負債約13,901,000港元。於2023年5月31日，租賃負債約2,428,000港元由本公司的汽車及本公司一名董事的個人擔保作抵押。

除本通函所披露者外，及除本集團內部負債及日常業務過程中的正常應付賬款外，於2023年5月31日，本集團並無任何其他重大債務證券（已發行或未償還，或法定或以其他方式設立但尚未發行）、定期貸款、其他借貸或本集團借貸性質的債務，包括銀行透支、承兌負債（正常貿易票據除外）、承兌信貸或租購承擔、債權證、按揭、押記（有擔保、無擔保、有抵押或無抵押），或於營業時間結束時尚未償還的其他重大或然負債或擔保。

就本債務聲明而言，外幣金額已按2023年5月31日營業時間結束時的概約匯率換算為港元。

董事並不知悉自2023年5月31日以來本集團的債務狀況有任何重大不利變動。

### 3. 重大變動

董事確認，自2022年12月31日（即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期）起至最後實際可行日期止（包括該日），本集團的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動。

### 4. 營運資金

董事經作出適當審慎查詢後認為，於完成後，經考慮收購事項的影響及本集團可動用之財務資源（包括本集團現時可動用之銀行融資、內部營運產生之資金以及現金及銀行結餘），本集團有充足的營運資金，足以應付自本通函刊發日期起計至少12個月之所需。

### 5. 本集團的財務及經營前景

隨著中國及其他國家放鬆新冠肺炎疫情的控制措施，同時採取經濟復甦措施，預期全球市場將逐步復甦。然而，鑒於疫情的後續影響，加上多個國家之間複雜的政治問題，本集團預計全球宏觀經濟仍然不穩定。面對全球經濟的不明朗因素，本集團對行業及本集團的未來發展仍保持審慎樂觀。

根據Precedence Research，預期2023年全球半導體材料市場的增長率將達到6.3%，而整體規模將達至4,858億美元的歷史新高。作為一家以技術為核心的知名製造商，本集團具備憑藉持續研發能力掌握最新行業趨勢的能力。

中國市場方面，由於中國政府推出多項促進經濟增長的政策，半導體需求預計將逐步復甦，市場將逐步適應新常態，以盡量減少疫情的持續影響。因此，市場對鍵合線及封裝膠的需求預期在未來幾年將有所增長，董事對業內長遠前景及本集團的未來發展感到樂觀。本集團將如期推出三個系列的固晶膠新產品，即環氧絕緣膠、硅膠絕緣膠及用於LED的導電銀膠，並在配方修改後將產品應用擴展至其他半導體及5G產業，以抓緊5G產業增長所帶來的機遇。此外，本集團亦已開發專門用於高功率集成電路及IGBT產品的新型銅合金鍵合線，並已獲得中國頂級客戶的驗證及認可。中國十大半導體功率集成電路公司之一已向本公司發出重銅合金鍵合線的訂單。預計新產品將在未來數年為本集團的收益作出貢獻。

此外，中國Mini-LED市場近年來增長迅速。更多配備Mini-LED的家電產品相繼推出，包括電視及遊戲顯示器等。與傳統LED相比，Mini-LED體積更小，可更精準地控制顯示器的背光。Mini-LED提高對比度及亮度，提供更佳畫質。Mini-LED亦較傳統LED更節能，故可延長便攜式設備的電池壽命。預期未來Mini-LED將廣泛用於國內電子產品的生產。鑑於Mini-LED市場持續增長，董事認為，收購事項將使本集團能夠把握Mini-LED行業預期市場增長所帶來的機遇，並通過豐富其產品結構保持本集團在封裝膠市場的競爭力。



仲量聯行企業評估及諮詢有限公司  
香港英皇道979號太古坊一座7樓  
電話 +852 2846 5000 傳真 +852 2169 6001  
公司牌照號碼：C-030171

敬啟者：

按照駿碼半導體材料有限公司（「**貴公司**」、「**客戶**」或「**駿碼**」）之指示，仲量聯行企業評估及諮詢有限公司（「**仲量聯行**」）已進行估值，須就於2023年4月30日（「**估值日期**」）的兩套知識產權（有關知識產權的更多詳情，請參閱「**背景**」一節）發表獨立意見。本報告編製日期為2023年7月18日（「**報告日期**」）。本次估值（「**估值**」）乃供 貴公司內部參考之用，並載入其公開披露文檔之中。

吾等之估值乃以市場價值為基準進行。市場價值之定義為「經適當市場推廣後，自願買方與自願賣方在知情、審慎和自願的公平交易情況下於估值日期就資產或負債進行交易的估計金額」。

## 背景

本次估值對象為駿碼科技投資控股有限公司（「**賣方**」或「**BVI Holdings**」）截至估值日期持有的兩項知識產權。第一個估值對象指「**COB**高清顯示器封裝成型」的整套技術（「**COB封裝技術**」或「**COB**」）。第二個估值對象指生產「**FC-BGA**低壓環氧成型化合物」的整套技術（「**FC-BGA封裝技術**」或「**FC-BGA**」）。該兩套知識產權統稱為「**估值對象**」或「**知識產權**」。

由BVI Holdings開發的COB封裝技術為應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新方法。該方法涉及環氧樹脂瞬間固化技術的開發，可瞬間固化，具有超強韌性、高密封性及高可靠性。該方法採用注塑工藝代替傳統的液體封裝材料點膠工藝；從而解決傳統液體膠點膠自流平問題。其具有高韌性、低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。COB封裝技術適用於小間距RGB Mini-LED模組，實現顯示模組集成，使顯示屏具有超輕、超薄的特性。董事會認為，COB封裝技術可採用用於Mini-LED行業的環氧樹脂瞬間固化技術。

同樣由BVI Holdings開發的FC-BGA封裝技術為製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新方法。該方法為塑料封裝(注塑)工藝，將環氧成型化合物擠出到模具中，並將半導體芯片嵌入環氧成型化合物中。該方法採用注塑工藝代替傳統的液體封裝材料點膠工藝；從而解決傳統液體膠點膠自流平問題。其亦具有低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。FC-BGA封裝技術適用於Mini-LED模組封裝的注塑工藝。董事會認為，FC-BGA封裝技術通過改變樹脂、促進劑及多元醇的類型及結構，可改進用於封裝的環氧樹脂成型材料，並提高成型工藝的持續性。

Mini-LED指尺寸在100到300微米之間，芯片間距在0.1到1毫米之間的LED芯片。更多配備Mini-LED的家電產品相繼推出，包括電視及遊戲顯示器等。與傳統LED相比，Mini-LED體積更小，可更精準地控制顯示器的背光。Mini-LED亦可提高對比度及亮度，提供更佳畫質。Mini-LED亦較傳統LED更節能，故可延長便攜式設備的電池壽命。

就COB封裝技術而言，根據賣方董事會會議記錄(「董事會會議記錄」)、項目報告(「項目報告」)及核數師報告(「核數師報告」)，項目於2007年1月開始，預算為45百萬港元，其後於2015年12月完成，產生總成本40百萬港元。

就FC-BGA封裝技術而言，根據董事會會議記錄、項目報告及核數師報告，項目於2010年1月開始，預算為14.4百萬港元，其後於2015年12月完成，產生總成本14百萬港元。

## 資料來源

對估值對象進行估值時，吾等已審閱若干資料，包括但不限於：

- 估值對象之背景；
- 與賣方估值對象有關之董事會會議記錄及項目報告；
- 估值對象之歷史財務資料，包括但不限於賣方的核數師報告；及
- 與估值對象業務相關之其他經營及市場資料。

吾等已與 貴公司及賣方管理層進行討論，對公開資料來源進行市場研究，以評估所獲之資料是否公平合理。吾等假設該等資料屬可靠及合法；且吾等於達致估值結論時在很大程度上倚賴該等所獲資料。

## 意見基礎

吾等乃參考國際評估準則理事會（「國際評估準則理事會」）頒佈之國際評估準則進行估值。所採用之估值程序包括審查估值對象之法律狀況及經濟狀況、評估估值對象擁有人或經營者所作出之主要假設、估計及聲明。所有對妥善了解評估屬必要之事項已於本估值報告內披露。

以下因素構成吾等意見基礎之重要部分：

- 整體經濟前景；
- 所涉及之資產性質及經營歷史；
- 估值對象之財務狀況；
- 從事相同業務類別之資產的市場導向型投資收益；
- 考慮及分析影響估值對象之微觀及宏觀經濟因素；及
- 對估值對象的戰術規劃、管理標準及協同性進行之分析。

吾等已規劃及進行評估，以取得所認為必要之一切資料及說明文件，從而有充足憑證對估值對象之估值發表意見。

## 估值方法

於達致吾等之評估價值時，吾等已考慮三種普遍採納的方法，即市場法、成本法及收入法。

**市場法**考慮近期就類似資產支付之價格，並對有關市價作出調整以反映所評估資產相對於市場可資比較資產在狀況及用途方面的差異。具備既有二級市場的資產，可採用此方法進行估值。使用該方法的好處是簡單、明確及快捷，且只需作出少量假設甚或毋須作出假設。另外，該方法使用公開可得輸入數據，故亦具備客觀性。然而，須注意有關可資比較資產之價值中存在固有假設，故有關輸入數據中亦含有隱藏假設。尋找可資比較資產亦非易事。此外，該方法完全依賴有效市場假說。

**成本法**根據類似資產之現行市價，考慮重製或重置所評估資產至全新狀況之成本，並就應計折舊或殘舊狀況（不論因外觀、功能或經濟方面而導致）作出撥備。成本法一般能為並無已知二級市場的資產提供最可靠的價值指標。雖然該方法具有簡單透明的優點，但並未直接納入有關標的資產所帶來經濟利益之資料。

**收入法**是將擁有權之預期定期利益轉換為價值指標。該方法乃基於知情買方不會就有關項目支付超過相等於具有相若風險概況之相同或大致相若項目之預期未來利益（收益）之現值金額的原則。該方法考慮未來溢利之預期估值，並有大量的經驗數值及理論解析可用作進行預期未來現金流的現值計算。然而，該方法依賴較長時間跨度內之大量假設，而結果可能受若干輸入數據之較大影響。而且，其僅可呈現單一情況。

於選擇最合適的方法時，吾等已考慮估值的目的是及因此使用的估值基準以及所得資料的可用度及可靠度，以進行分析。吾等亦已考慮各種方法對估值對象性質及情況的相對優點及缺點。收入法並不合適，因為此方法需要估值對象之詳細資料及長期財務預測，但吾等並無該等資料以及客觀的證明文件和資訊。市場法並不合適，因為其要求與估值對象可資比較的市場交易作為價值指標。然而，吾等尚未發現任何與估值對象可資比較的當前市場交易。

在本報告中，吾等已採用成本法，同時考慮估值對象的性質及背景。貴公司已解釋，在其經營的行業（即半導體封裝）中，任何新技術的研發通常至少要在其可能的部署前3至5年進行規劃。貴公司進一步告知，市場需求是部署新技術的一個重要因素。估值對象於2015年完成開發時，市場上現有產品的各自產品生命週期尚未終結，Mini-LED尚未開始在市場上普及，仍未達到大規模生產階段。Mini-LED直至近期才在市場上變得更加普及，部分客戶向貴公司諮詢Mini-LED產品，尤其是與估值對象相關的產品。儘管估值對象具有市場潛力，但由於缺乏歷史經營往績記錄，吾等認為成本法在本次估值中最為合適。

本次估值中於達致估值對象的市值時已採用成本法項下的重置成本法，方式為釐定典型參與者尋求創造或獲得提供類似功能及同等功效的資產將產生的相關成本。重置成本乃根據與估值對象開發相關的直接材料、製造供應及直接勞工的歷史成本估計得出，然後根據實際項目開發期與估值日期之間的價格水平變動進行調整。

## 主要假設

於本次估值中被認為具有重大敏感度影響的假設已予評估，以為達致吾等的估值提供更為準確及合理的基準。於釐定估值對象市值時已作出以下主要假設：

- 估值主要基於吾等所獲得之核數師報告、董事會會議記錄及項目報告等相關資料，以確定在開發估值對象時部署的直接材料及製造供應的重置成本；吾等假設所提供的資料乃於合理基礎上編製，反映個別知識產權的各個方面，包括但不限於市場條件、經濟基本面、直接材料及製造供應的單價等；
- 吾等假設將於對維持所評估資產之特徵及完整性屬必要之時間內維持審慎及有效管理政策；
- 吾等假設現行政治、法律、技術、財政或經濟狀況不會發生可能對估值對象業務構成不利影響的重大變動；
- 吾等假設相關合約及協議所訂明的操作及合約條款將會得到履行；
- 吾等已取得營業執照及公司註冊成立文件的副本。吾等已假設該等資料均為可靠且合法。於達致吾等的估值意見時，吾等在很大程度上倚賴該等資料；
- 吾等假設 貴公司／賣方所提供的財務及營運資料（例如管理賬目、合約協議及製造能力）準確無誤，並於達致吾等的估值意見時在很大程度上倚賴該等資料；及
- 吾等假設並無與所估值資產相關且可能會對所呈報價值構成不利影響的未有公開或未能預計之情況。此外，吾等概不對估值日期後之市況變動承擔任何責任。

### 使用重置成本法進行估值

估值對象的市值乃根據與估值對象開發相關的直接材料、製造供應及直接勞工的歷史成本估計得出，然後根據實際項目開發期與估值日期之間的價格水平變動進行調整。

### 年期

用於開發COB封裝技術及FC-BGA封裝技術的歷史年期分別為9年及6年。誠如與 貴公司及賣方所討論，由於在歷史研發期間成果過時而導致延誤，複製COB及FC-BGA已確定分別需要6年及4年時間。

### 製造供應

製造供應主要包括用於進行實驗及測試以開發所需產品的專用機器。

根據機器的性質，製造供應的預期使用壽命為15年。經參考核數師報告、董事會會議記錄及項目報告的歷史記錄，吾等參考客戶／賣方管理層所提供的下列最新報價，採用直線法估計折舊開支：

a) *COB封裝技術*

項目	報價 (港元)	數量	使用壽命 (年)	折舊開支 (港元)
離子遷移絕緣測試系統	10,827,897	1	15	4,331,159
C-SAM (超聲掃描顯 微鏡)	1,645,129	1	15	658,051
SEM (掃描電子顯微鏡)	1,338,794	1	15	535,518
X射線探測器	1,287,247	1	15	514,899
高低溫交變試驗箱	964,386	1	15	385,754
流變儀	884,966	1	15	353,986
TMA (熱機械分析儀) <sup>1</sup>	782,854	1	15	208,761
溫濕度試驗箱 <sup>1</sup>	746,741	1	15	199,131
DSC (差示掃描量熱法) <sup>1</sup>	726,126	1	15	193,634
其他 <sup>1</sup>	3,499,096	20	15	1,366,414
			總計	<u><u>8,747,307<sup>2</sup></u></u>

## b) FC-BGA封裝技術

項目	報價 (港元)	數量	使用壽命 (年)	折舊開支 (港元)
冷熱衝擊試驗機	1,107,342	1	15	295,291
DMA (動態機械分析儀)	1,021,114	1	15	272,297
TGA (熱重分析儀)	794,200	1	15	211,787
TMA (熱機械分析儀) <sup>1</sup>	782,854	1	15	104,381
溫濕度試驗箱 <sup>1</sup>	746,741	1	15	99,565
DSC (差示掃描量熱法) <sup>1</sup>	726,126	1	15	96,817
GC-MS (氣相層析質 譜儀)	623,175	1	15	166,180
其他 <sup>1</sup>	1,883,077	15	15	468,946
			總計	<u>1,715,264<sup>2</sup></u>

附註1. 製造供應中，有7個項目在COB封裝技術及FC-BGA封裝技術的開發中均有需要。在此估值中，該等項目的折舊開支已假設由兩項知識產權分擔。

2. 因四捨五入關係，總數不一定與個別數額總和相對應。

## 直接勞工

直接勞工用於進行實驗及分析數據，目的是優化產品性能或功能。經參考核數師報告、董事會會議記錄及項目報告的歷史記錄，吾等根據各種公眾來源所得下列資料透過調整薪酬水平來估計直接勞工成本：

**a) COB封裝技術**

職位	每月成本 (港元)	聘用期 (月)	數量	總成本 (港元)
項目經理	56,781	72	1	4,088,198
研發工程師	28,096	72	5	10,114,635
技術員	21,862	72	3	4,722,106
			總計	<u><u>18,924,938<sup>1</sup></u></u>

**b) FC-BGA封裝技術**

職位	每月成本 (港元)	聘用期 (月)	數量	總成本 (港元)
項目經理	56,781	48	1	2,725,465
研發工程師	28,096	48	2	2,697,236
技術員	21,862	48	2	2,098,714
			總計	<u><u>7,521,415<sup>1</sup></u></u>

附註1. 因四捨五入關係，總數不一定與個別數額總和相對應。

## 直接材料

直接材料主要包括化學材料成分，以確定產品的理想配方。估值中採用的直接材料成本乃基於核數師報告、董事會會議記錄及項目報告中提取的下列實際產生成本所計算：

a) *COB*封裝技術

項目	數量 (公斤)	平均單位價格 (港元／公斤)	總成本 (港元)
脂環族環氧樹脂	2,600	131.36	341,540
多官能基的脂環族環氧樹脂	1,170	386.50	452,200
光擴散粉體	5,700	152.16	867,300
其他	/	/	198,764
		總計	<u><u>1,860,000<sup>1</sup></u></u>

b) *FC-BGA*封裝技術

項目	數量 (公斤)	平均單位價格 (港元／公斤)	總成本 (港元)
TGIC (異氰脲酸三縮水甘油酯)	1,370	484.82	664,210
巰基硅烷偶合劑	60	1,224.42	73,465
脫模劑	80	991.56	79,325
其他	/	/	183,137
		總計	<u><u>1,000,000<sup>1</sup></u></u>

附註1. 因四捨五入關係，總數不一定與個別數額總和相對應。

## 計算估值結果

於估值日期，估值對象市值的計算如下：

### COB封裝技術

參數	輸入數據(港元)
直接材料	1,860,000
製造供應	8,747,307
直接勞工	18,924,938
<b>總重置成本</b>	<b>29,532,245</b>

### FC-BGA封裝技術

參數	輸入數據(港元)
直接材料	1,000,000
製造供應	1,715,264
直接勞工	7,521,415
<b>總重置成本</b>	<b>10,236,678</b>

## 估值意見

估值結論乃按照獲接納之估值程序及慣例進行，在較大程度上依賴多項假設之使用及對眾多不確定因素之考慮，惟並非所有假設及不確定因素均可輕易量化或確定。此外，儘管吾等認為假設及其他有關因素屬合理，惟該等假設及因素本身在業務、經濟及競爭方面受重大不確定因素及或然因素影響，當中大部分不受賣方、貴公司及仲量聯行之控制。

吾等不擬就需要應用法律或其他專業技術或知識，且超越估值師一般專業技術或知識之事宜發表任何意見。吾等之結論乃假設估值對象將於維持所評估資產之特徵及完整性之任何合理及必要時間內維持審慎管理。

本報告之刊發受隨附限制條件的規限。

## 獨立性聲明

吾等確認，就吾等所深知及確信，吾等獨立於貴公司及賣方，且未違反專業會員所規定的任何獨立性要求。吾等收取的費用不取決於估值結論。

## 對估值的意見

根據吾等的調查及分析結果，吾等認為，COB封裝技術於估值日期之市值可合理評估為**29,532,000港元**，而FC-BGA封裝技術於估值日期之市值可合理評估為**10,237,000港元**。

此 致

駿碼半導體材料有限公司  
董事會 台照  
香港新界  
白石角香港科學園  
二期尚湖樓2樓208室

代表  
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司  
執行董事  
陳銘傑  
謹啟

2023年7月18日

附註： 陳銘傑先生是香港會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員，亦為英國皇家特許測量師學會之資深會員。彼為國際認證評估專家及新加坡特許估值師及評估師。彼監督仲量聯行的業務評估服務，擁有逾20年的會計、審計、企業諮詢及估值經驗，曾為中國、香港、新加坡及美國境內不同行業之眾多已上市和現正上市公司提供廣泛之估值服務。

## 限制條件

1. 於編製本報告時，吾等倚賴於客戶／賣方及／或其代表向吾等提供之財務資料、預測、假設及其他數據之準確性、完整性及合理性。吾等並無開展任何審核性質工作，亦未被要求表達審核或可行意見。吾等對該資料之準確性並不承擔任何責任。吾等之報告於客戶／賣方達致估值結論時作為分析之一部分使用，而基於上述理由，達致有關估值對象價值之最終責任由客戶獨力承擔。
2. 吾等已解釋，作為吾等服務委聘過程之一部分，董事之責任為確保妥善存置會計賬目，且財務資料及預測乃根據有關準則及公司條例真實公平編製。
3. 吾等已向視為可靠之來源獲取公共資料及行業及統計資料；然而，吾等對該資料之準確性或完整性並無作出任何聲明，亦並未核實而接受該資料。
4. 客戶／賣方之董事會及管理層已審閱本報告並同意及確認該等基準、假設、計算及結果為恰當合理。
5. 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司無須就是項評估以及參考本文所述的項目在法院或向任何政府機關提供證供或出席。倘須任何形式之後續服務，相關開支及時間成本將由閣下承擔。該等形式之額外工作可能未經事前通知閣下而進行。
6. 概不擬就超出估值師範圍而須具備法律或其他特殊專業知識的事項發表任何意見。
7. 報告的使用及／或有效性須受該協議條款及結算所有費用及所有開支規限。
8. 吾等之結論乃假設將於維持估值對象之特徵及完整性屬必要之時間內維持審慎及有效管理政策。
9. 吾等假設並無隱瞞或根據審閱標的事項所產生意料之外之條件，該等條件或對已報告審閱結果產生不利影響。此外，吾等對估值日期後市況、政府政策或其他條件之變動概不承擔責任。由於事項及情況經常未能按預期發生，吾等對客戶／賣方所預期獲取之結果是否能達成概不提供保證；實際及預期結果差異可能重大；達致預期結果取決於管理層之行動、計劃及假設。

10. 本報告之編製僅供內部使用，未經吾等事先書面同意，報告不應以任何方式全部或部分在任何文件、通函或聲明內提述或引述、或分發全部或部分內容至或抄送至任何第三方。即使事先得得到吾等的書面同意，吾等也不對任何第三方負責，惟本報告的客戶除外。吾等的客戶應提醒任何將收到此報告的第三方，客戶將需要承擔因第三方使用此報告而產生的任何後果。在任何情況下吾等概不對任何第三方負責。
11. 本報告乃客戶之機密，所表達之估值計算僅就估值日期該協議所載之目的而言有效。根據吾等之標準守則，吾等必須聲明本報告及估值僅供收件方使用，吾等不會就其內容之全部或任何部分對任何第三方負責。
12. 倘對估值對象擁有權益之人士向吾等作出任何特別或特定聲明，吾等有權倚賴該聲明而毋須對該聲明之準確性開展進一步調查。
13. 客戶／賣方同意彌償及確使吾等及吾等之員工免受任何及所有虧損、申索、行動、損失、開支或責任，包括可能成為與本委聘有關之合理律師費。吾等就是次委聘提供的服務所涉及責任上限（不論是否因合約、疏忽或其他形式採取的行動）乃以吾等就導致責任的服務或工作報告部分而獲支付的收費為限。即使已獲告知可能出現上述情況，吾等亦概不會就任何因而產生、特殊、附帶或懲罰性損失、損害或開支（包括但不限於失去的溢利、機會成本等）承擔任何責任。
14. 吾等並非環境、結構或工程顧問或核數師，吾等不對任何有關實際或潛在責任負責，同時鼓勵對資產估值效果進行專業評估。吾等並無進行或提供相關評估，亦無考慮對相關資產的潛在影響。
15. 此估值部分以客戶／賣方之管理層及／或其代表提供之歷史財務資料及未來預測為依據。吾等已假設所提供資料之準確性及合理性並於估值計算時於頗大程度上依賴有關資料。由於預測與未來有關，預測與實際結果通常將會出現差異，於若干情況下，該等差異或會屬重大。因此，得出之價值或會顯著不同，惟須視乎任何上述資料所需之調整而定。

16. 本報告及其內所達致之估值結論僅為客戶就本報告內訂明之單一及特定目的之用。此外，作者不擬將報告及估值結論作為投資意見或融資或交易參考，任何報告讀者不得以任何方式將其詮釋為投資意見或融資或交易參考。估值結論乃基於來自客戶／賣方及其他來源之資料而作出之考量。涉及估值對象的實際交易可能以較高或較低價值達成，視乎該項交易之情況，以及買方及賣方當時之知識及積極性而定。交易金額無需接近本報告的估計結果。
  
17. 客戶／賣方之董事會、管理層、員工以及代表已向吾等確認，彼等於本次估值或計算過程中乃獨立於仲量聯行。倘存在任何利益衝突或潛在獨立性問題而可能影響吾等進行工作時的獨立性，客戶／賣方及／或其代表應立即告知吾等，而吾等或需終止工作並可能就所進行的工作或保留或委聘的人力收取費用。

## 1. 責任聲明

本通函之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 2. 權益披露

### (A) 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有之權益及淡倉

於最後實際可行日期，董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被列作或視為擁有之權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條規定須記入該條所述登記冊之權益或淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

#### (i) 於股份之好倉

董事姓名	權益性質／ 持股身份	所持股份數目	佔已發行股份 的百分比 (附註1)
周博士	受控制法團權益 (附註2)	357,000,000	50.60%
周教授	受控制法團權益 (附註2)	357,000,000	50.60%
	實益擁有人	510,000	0.07%
李超凡先生	實益擁有人	16,050,000	2.27%

附註：

- 於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為7,055,000港元，分為705,500,000股股份。
- BVI Holdings分別由周博士及周教授實益擁有40%及60%權益。根據證券及期貨條例，周博士及周教授被視為於BVI Holdings持有的357,000,000股股份中擁有權益。

## (ii) 於本公司相聯法團股份之權益

董事姓名	相聯法團之名稱	權益性質／持股身份	於相聯法團所持 ／擁有權益的股 份數目	股權百分比
周教授	BVI Chows (附註1 及 2)	實益擁有人	6	60.00%
周博士	BVI Chows (附註1 及 2)	實益擁有人	4	40.00%
周教授	BVI Holdings (附註1 及 2)	受控制法團權益	10,000,000	100.00%
周博士	BVI Holdings (附註1 及 2)	受控制法團權益	10,000,000	100.00%
李超凡先生	BVI Holdings (附註3)	實益擁有人	714,286	7.14%

## 附註：

1. BVI Chows持有BVI Holdings 100%權益。BVI Holdings持有本公司50.60%權益。因此，根據證券及期貨條例，BVI Chows及BVI Holdings為本公司之相聯法團。
2. 周博士及周教授分別於BVI Chows的40%及60%已發行股本中擁有權益。BVI Chows持有BVI Holdings 100%權益。因此，根據證券及期貨條例，周博士及周教授被視為擁有BVI Holdings 100%權益。
3. BVI Chows就BVI Holdings已發行股本中的714,286股股份向李超凡先生發行金額為10,000,000港元的可交換貸款票據。該等可交換貸款票據的到期日已延長。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有或視為擁有須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所（包括根據證券及期貨條例之有關條文當作或被視為擁有之權益或淡倉）之任何其他權益或淡倉；或(b)根據證券及期貨條例第352條規定記入該條所述之登記冊之任何其他權益或淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所之任何其他權益或淡倉。

**(B) 主要股東及其他人士於股份或相關股份的權益及淡倉**

據董事所知，於最後實際可行日期，下列人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中（直接或間接）擁有或視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或計入本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內之權益或淡倉：

*於股份之好倉*

股東名稱	權益性質／持股身份	所持股份數目	佔已發行股份的百分比 (附註1)
BVI Holdings	實益擁有人 (附註6)	357,000,000	50.60%
BVI Chows	受控制法團權益 (附註2及附註6)	357,000,000	50.60%
Chow Fung Wai Lan Rita女士 (「周女士」)	配偶權益 (附註3)	357,510,000	50.67%
Chow Kuo Li Jen女士	配偶權益 (附註4)	357,000,000	50.60%
馬亞木先生 (「馬先生」)	實益擁有人	152,490,000	21.61%
Cheng Pak Ching女士	配偶所持權益 (附註5)	152,490,000	21.61%

*附註：*

- 於最後實際可行日期，本公司已發行股本7,055,000港元，分為705,500,000股股份。
- BVI Chows持有BVI Holdings的100%權益，因此根據證券及期貨條例被視為於BVI Holdings所持的357,000,000股股份中擁有權益。
- 周女士為周教授的配偶。根據證券及期貨條例，周女士被視為於周教授擁有權益的所有股份中擁有權益。
- Chow Kuo Li Jen女士為周博士的配偶。根據證券及期貨條例，Chow Kuo Li Jen女士被視為於周博士擁有權益的所有股份中擁有權益。
- Cheng Pak Ching女士為馬先生的配偶。根據證券及期貨條例，Cheng Pak Ching女士被視為於馬先生擁有權益的所有股份中擁有權益。
- 執行董事周博士及執行董事周教授為BVI Chows和BVI Holdings之董事。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事並不知悉任何其他人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或記入本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內之權益或淡倉。

### 3. 重大訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本集團任何成員公司概無任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟、仲裁或申索。

### 4. 董事服務合約

於最後實際可行日期，董事概無與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何於一年內不會屆滿或不可由本集團終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）的服務合約。

### 5. 重大合約

本集團成員公司於緊接最後實際可行日期前兩年內概無訂立任何屬或可能屬重大之合約（並非於本集團日常業務過程中訂立之合約）。

### 6. 於資產或合約的權益

於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司自2022年12月31日（即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的編製日期）以來所收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

於最後實際可行日期，概無董事於最後實際可行日期仍然存續且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

### 7. 董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自之緊密聯繫人於任何與本集團業務存在或可能存在直接或間接競爭的業務中擁有任何根據GEM上市規則須予披露的權益。

## 8. 其他資料

本公司之公司秘書蔡建龍先生為香港會計師公會會員。

本公司之註冊辦事處位於Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司的證券登記總處及過戶代理為Ocorian Trust (Cayman) Limited，其地址為本公司註冊辦事處所在地。本公司之香港股份過戶登記處為寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

本公司於香港的主要營業地點為香港新界白石角香港科學園2期尚湖樓2樓208室。

本通函備有中英文兩種版本。如有歧義，概以英文版本為準。

## 9. 專家資質及同意書

以下為提供本通函所載意見或建議之專家之資質：

名稱	資質
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	獨立估值師
衍丰企業融資有限公司	根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團

於最後實際可行日期，該等專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券之權利(不論能否依法強制執行)。

於最後實際可行日期，該等專家概無於本集團任何成員公司自2022年12月31日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表之編製日期)以來所收購或出售或租用或擬收購或出售或租用之任何資產中，擁有任何直接或間接權益。

該等專家已就本通函之刊發發出同意書，同意按本通函所載之形式及內容轉載其函件或報告(視情況而定)或引述本通函所載之名稱，且迄今並無撤回其同意書。

## 10. 展示文件

下列文件的電子版本將於本通函日期起計14日期間在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.nichetech.com.hk](http://www.nichetech.com.hk))展示及刊發：

- (a) 該協議；
- (b) 獨立財務顧問函件；
- (c) 知識產權估值報告；
- (d) 附錄三「專家資質及同意書」一段所述的獨立估值師及獨立財務顧問同意書；  
及
- (e) 本通函。

# 股東特別大會通告



**Niche-Tech Semiconductor Materials Limited**

**駿碼半導體材料有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

## 股東特別大會通告

茲通告駿碼半導體材料有限公司(「本公司」)謹訂於2023年8月2日(星期三)下午二時三十分假座香港新界白石角香港科學園二期尚湖樓2樓208室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案。

### 普通決議案

#### 「動議：

謹此批准、確認及追認由駿碼科技(香港)有限公司及駿碼科技投資控股有限公司訂立之日期為2023年6月14日之協議(「協議」)(註有「A」字樣之協議副本已提交大會，並由大會主席簽署以資識別)及協議之條款及條件，並據此收購協議項下之製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術及製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術之知識產權(「收購事項」)；謹此授權任何一名本公司董事(「董事」)採取一切其可能認為就與協議及實施項下擬進行之交易有關或使之生效而言屬必要、適宜、權宜或合宜之有關行動及事宜及代表本公司簽署及簽立一切有關其他文件或文據(包括在有需要時加蓋本公司之公司印鑑)，以及同意與此有關之事宜之有關修改、修訂或豁免，而有關修改、修訂或豁免屬行政性質及附屬於協議及／或據此擬進行之交易之實施、或屬協議所附帶。」

承董事會命  
駿碼半導體材料有限公司  
執行主席兼執行董事  
周博軒

香港，2023年7月18日

開曼群島註冊辦事處：  
Windward 3  
Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：  
香港新界  
白石角  
香港科學園二期  
尚湖樓2樓208室

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委派他人為其受委代表代其出席並於會上投票。持有兩股或以上本公司股份之本公司股東可委派多於一名受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 無論閣下是否擬親身出席大會，均務請按照隨附之代表委任表格所印列之指示填妥並交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視作撤銷論。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核實副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶及登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
4. 倘屬本公司股份之聯名持有人，則該等聯名持有人中任何一名均可就該等股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就該等股份名列首位之其中一名上述人士方有權就此投票。
5. 本通告所載之決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，執行董事為周博軒博士、周振基教授及石逸武先生，非執行董事為李超凡先生及獨立非執行董事為吳宏偉教授、潘禮賢先生及戴進傑先生。